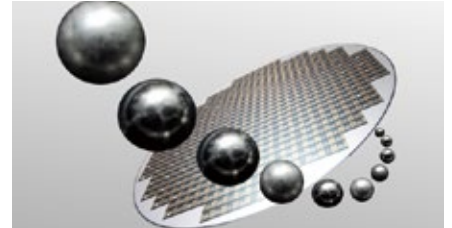


高信頼性WLCSP用ソルダボール

A high-reliability WLCSP solder ball

特長

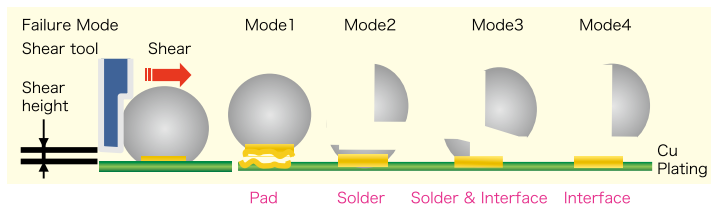
- Wafer電極に接合強度の高いバンプを形成
- Wafer電極など銅めっき被膜に良好な濡れ性を示す
- パッケージされたM758は、耐熱疲労特性に優れている



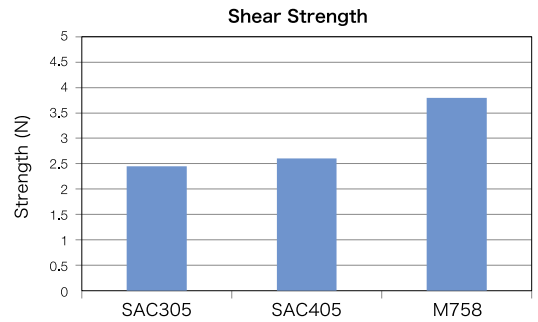
仕様

- M758は、Wafer電極に接合強度の高いバンプを形成

破壊モード



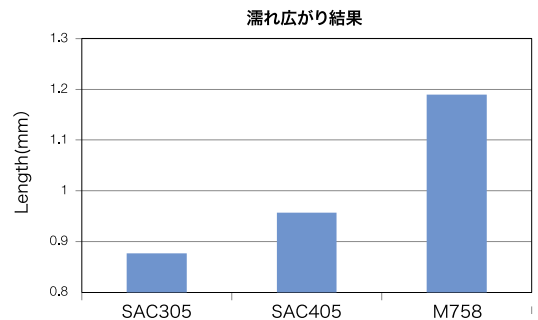
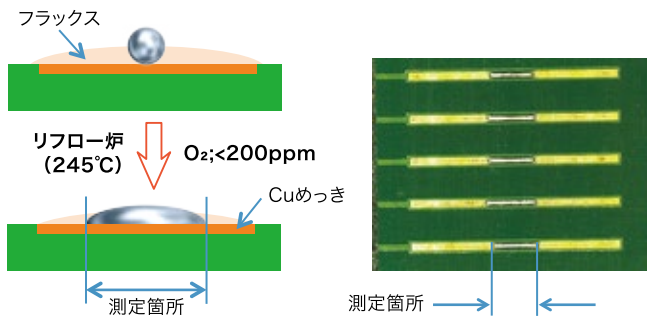
試験での破壊モードは、全てMode4;界面破壊である



M758は、Ni添加による界面改質効果によりPKGレベルで良好なバンプ強度を有する

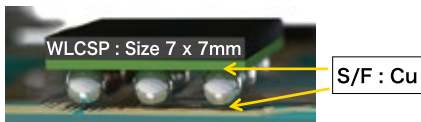
- M758は、Wafer電極など銅めっき被膜に良好な濡れ性を示す

試験方法

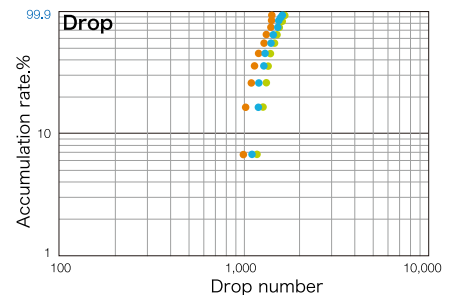
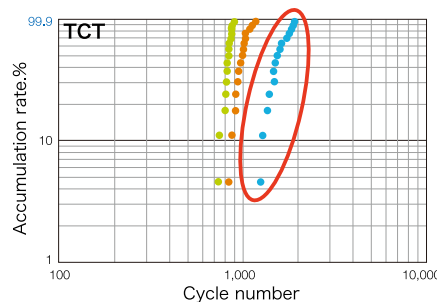


M758は、Cuメッキを施すPKGに良好な濡れ性を有する

- パッケージされたM758は、温度サイクル試験で良好な結果を示す



Product Name	Composition	Melting Point (%)	Note
M705	SAC305	217-220	Pb-free Standard
M710	SAC405	217-229	
M758		205-215	Suitable material for WLP



M758は、Bi添加による固溶強化で従来品のSAC305やSAC405と比較し、耐熱疲労特性に優れている。また、耐落下衝撃性では同等以上の結果を有する